

A 股代码：688347

A 股简称：华虹公司

公告编号：2025-010

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
- 公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 38,057.62 万元。

经公司董事会决议，基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

公司 2024 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的

发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。同行业竞争对手每年都将大量资金投入新厂基建、产能扩充和产品研发。在此背景下，公司需要投入大量资金用于扩充产能、提升技术水平和研发能力以保持足够的技术竞争力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司正处于产能扩张期，提高产能供给能力和加大工艺研发力度的重要发展阶段。公司紧紧围绕整体发展战略，持续实践先进“特色 IC+功率器件”工艺布局，持续为客户及市场提供丰富的产品选择。公司会始终以持续盈利为目标，不断提高经营管理水平，持续不断的进行技术突破，巩固并提升市场占有率，在保持合理毛利的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

报告期内，公司全年实现营业收入 1,438,830.77 万元人民币，实现归属于上市公司股东的净利润 38,057.62 万元人民币。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足研发投入、业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司 2024 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发创新、项目建设及设备购置等需求。公司将继续严格按照相关法律法规和公司章程等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）中小股东参与现金分红决策

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，满足业务规模的增长需求，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开董事会会议，审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东周年大会审议，经批准后实施。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日